毅嘉科技股份有限公司

Act with Purpose　Impact with Vision

法人說明會

2026年10月15日



議程

時間	程序
14:00~14:30	報到
14:30~15:10	2026第三季營運狀況說明
	策略佈局及重要事業發展 營運展望
15:10~15:30	Q&A
15:30	法說會結束

免 責 聲 明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內容，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。

- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。

- 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法，對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

毅嘉科技｜公司概覽

股票代號：2402

創立於 1983 年

總部：台灣林口

一站式整合解決方案
（機構＋電子＋散熱）

全球製造據點

台灣｜蘇州｜中山｜檳城及**居林**

員工人數：3,431 人
（截至 2026 年 9 月）



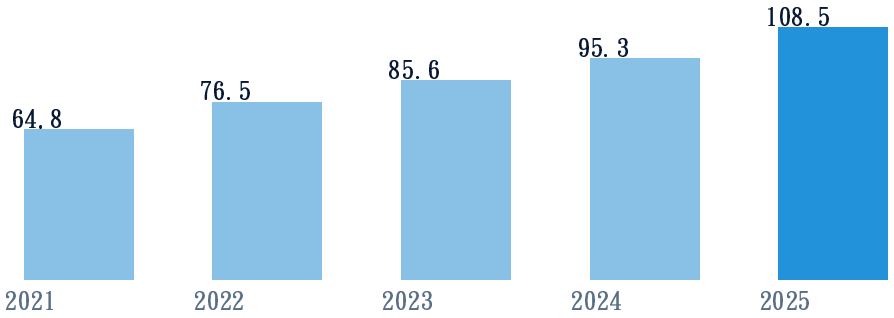
2025 年營收

新台幣 108.5 億元

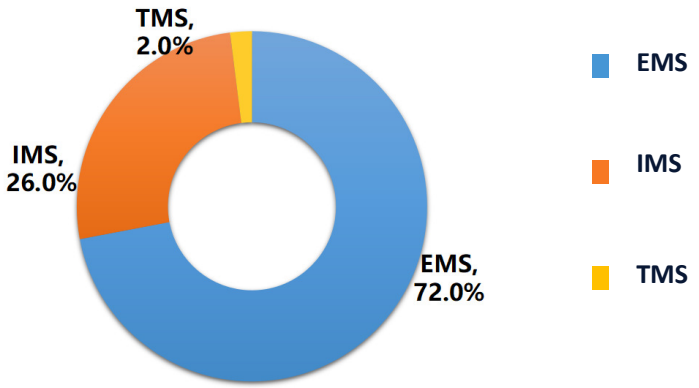
營收成長｜2021－2025

合併營收（新台幣億元）

年複合成長率：13.75%



截至 2026 年 9 月｜營收產品結構



ESG｜溫室氣體排放

較 2021 基準年減少 **53.62%**

近五年平均股東權益報酬率

7.76%

本次法說：四項關鍵訊息

01

財務表現｜Financial Performance

營收持續強勁成長(前三季94.98億YoY+17%；單季34.17億)，Q2、Q3毛利率逐步回升；持續提升營運效率與獲利品質。

02

營運展望｜Business Outlook

第四季成長動能加速，AI光通訊新專案(散熱型金屬外殼 Q3-26/FC-SMT Q4-26/Msap Q3-27)陸續進入量產，帶動2027年高度成長。

03

價值提升｜Value Creation

新產品(車用Touch Sensor模組Q2-26)、新技術與馬來西亞生產基地(車用儲能Q1-26)發揮效益，推動產品組合優化與模組化轉型。

04

長期展望｜Long-term Growth

深化全球製造布局，評估北美產能擴充，提升全球交付能力，追求營收與獲利同步成長。

2026年第三季營運績效

2026年第三季QoQ合併損益

單位：新台幣仟元

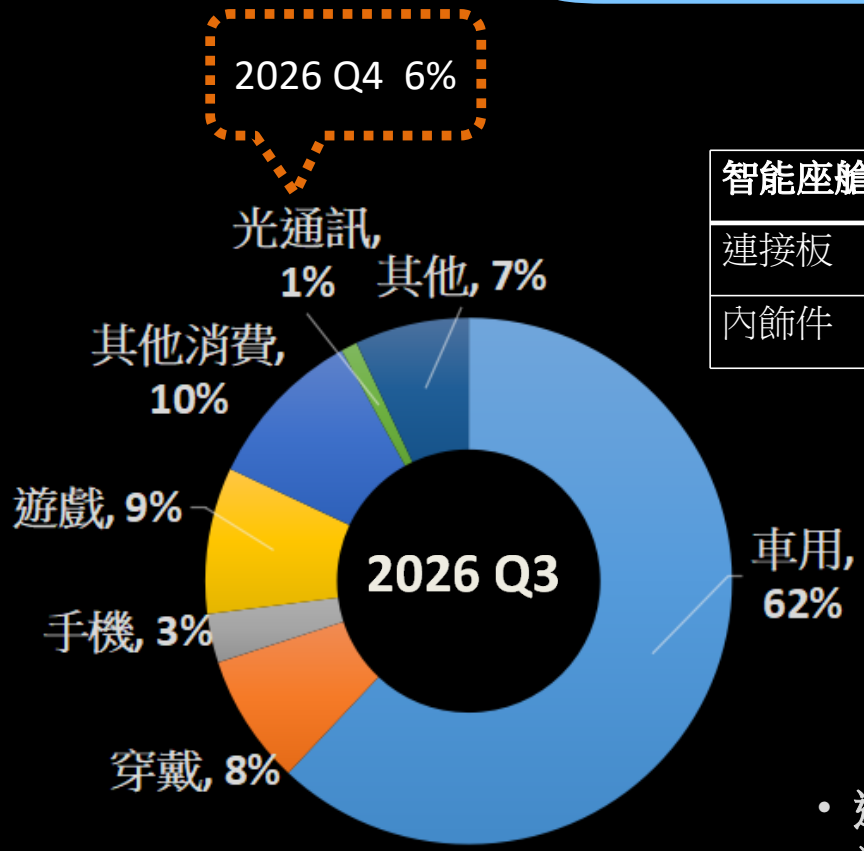
	2026年Q3		2026年Q2	
	金額	%	金額	%
營業收入	3,416,727	100	3,271,270	100
營業成本	2,928,903	86	2,807,440	86
營業毛利	487,824	14	463,830	14
營業費用	322,576	9	279,301	8
營業淨利	165,248	5	184,529	6
營業外收支淨額	(24,801)	(1)	(22,311)	(1)
稅前淨利	140,447	4	162,218	5
所得稅費用	39,059	1	41,494	1
稅後淨利	101,388	3	120,724	4
每股盈餘	0.33		0.39	

2026年前三季度YoY合併損益

單位：新台幣仟元

	2026前三季		2025前三季	
	金額	%	金額	%
營業收入	9,497,989	100	8,124,142	100
營業成本	8,186,037	86	6,595,117	81
營業毛利	1,311,952	14	1,529,025	19
營業費用	881,595	9	859,202	11
營業淨利	430,357	5	669,823	8
營業外收支淨額	(88,129)	(1)	39,394	1
稅前淨利	342,228	4	709,217	9
所得稅費用	99,504	1	142,672	2
稅後淨利	242,724	3	566,545	7
每股盈餘	0.79		1.86	

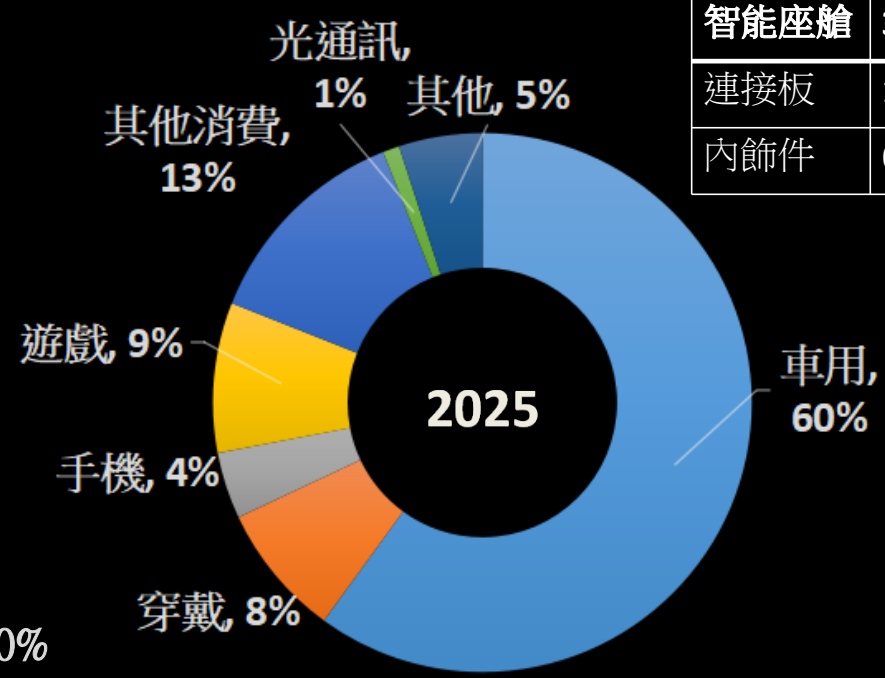
產品應用占營收比重



智能座艙	40%
連接板	19%
內飾件	3%

模組產品占比24%

- 遊戲 9% +0%
- 光通訊 1% +0%
- 車用相關 62% +2%
- 穿戴相關 8% +0%
- 手機相關 3% -1%



智能座艙	35%
連接板	19%
內飾件	6%

模組產品占比20%

策略產品佈局與重要事業發展

WWW.HOTEMAILTEMPLATES.COM

產品技術及應用藍圖

端 A I 雲

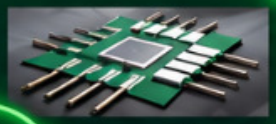
管 I A 端

2028

智能製造



矽光子



2027

智能穿戴眼鏡



光通訊模組







靈巧手傳動方案

核心技術

Interconnect
電路板

SMT+Assy
貼裝

類封裝/光學對位方案

ichia

新材料/
熱管理方案
AI伺服器

Thermal
散熱

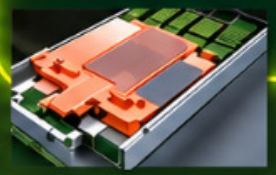
Mechanics
機構

電機模組/
儲能方案
智能駕駛

數據中心









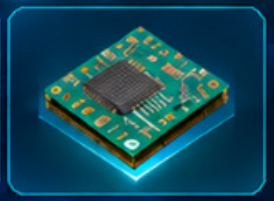
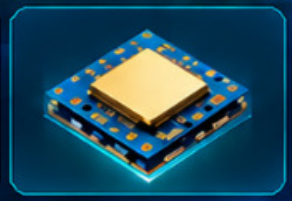
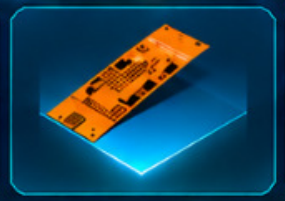
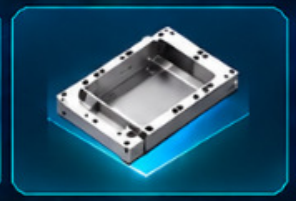


智能物流



以光電機電整合能力 驅動 AI 與智慧移動的未來

Opto-Electro-Mechanical Integration Empowering the Next Wave of AI and Smart Mobility

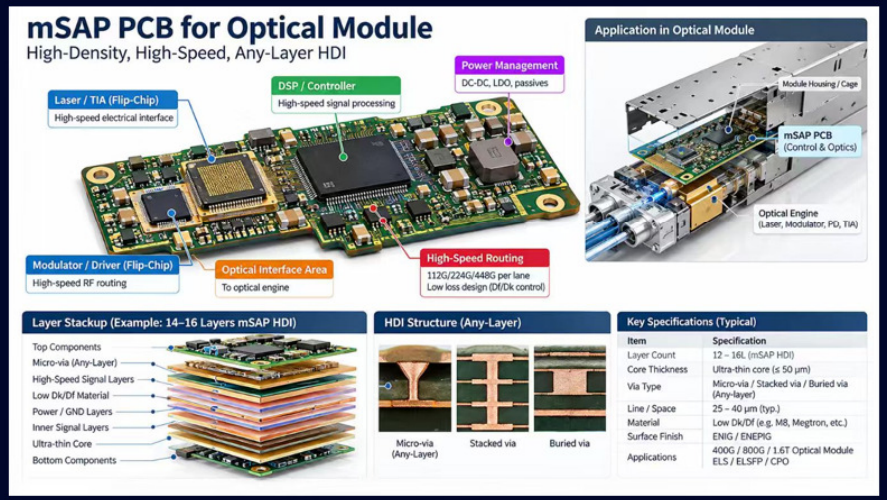
市場趨勢 Market Trends	AI / 數據中心 AI & Data Center	智慧移動 Smart Mobility	人機互動 Human-Machine Interaction	穿戴式運算 Wearable & Spatial Computing
策略市場 Strategic Markets				
核心技術平台 Technology Platforms							
主要 SBU Key Business Unit	EMS / TMS	IMS	IMS / EMS	
策略定位 Strategic Positioning	AI 時代的高速連接核心	邁向電動化與智慧移動	賦能機器智能與物理世界互動	連接數位與真實世界

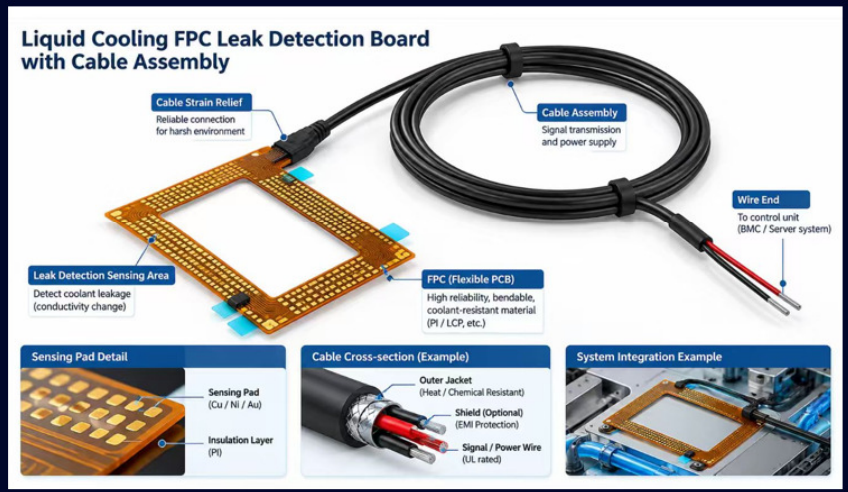
Electrical Module Solution

ichia EMS

AI 成長軸心

應用場景	核心能力	產品類別	目前定位
高速光通訊收發模組	Flip Chip	PCBA	新成熟技術
高速光通訊收發模組	MSAP 高密度線路製程	PCB	新技術研發
伺服器機櫃液冷系統	液冷測漏板	FPCA	成熟能力



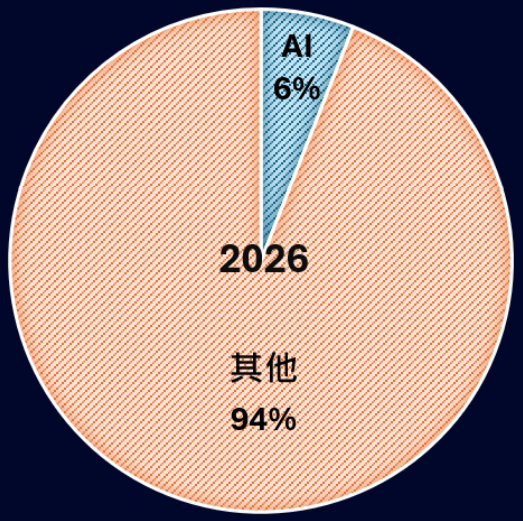


EMS

AI 營收成長比例

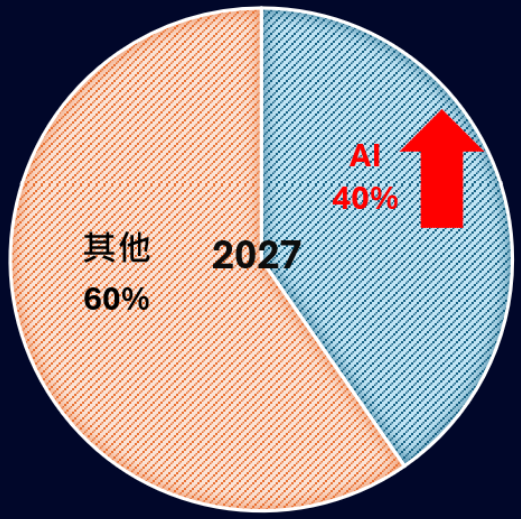
2026

- Flip-chip Q3 完成認證，Q4 導入量產
- mSAP Q4 啟動客戶樣品打樣
- 液冷測漏板 Q4 導入量產



2027

- 產能爬坡, 主要營收動力
- 2026：6% → 2027：40%

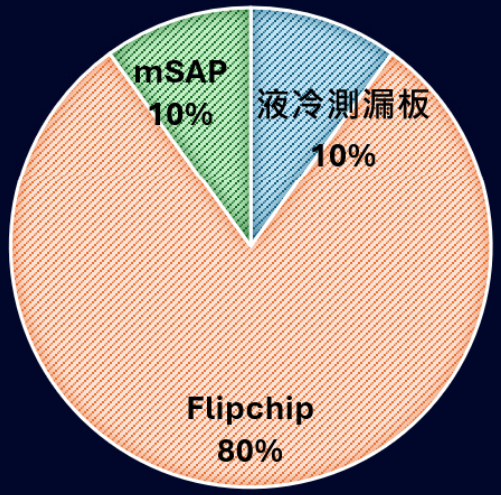


ichia EMS

2027 AI 技術與產品布局

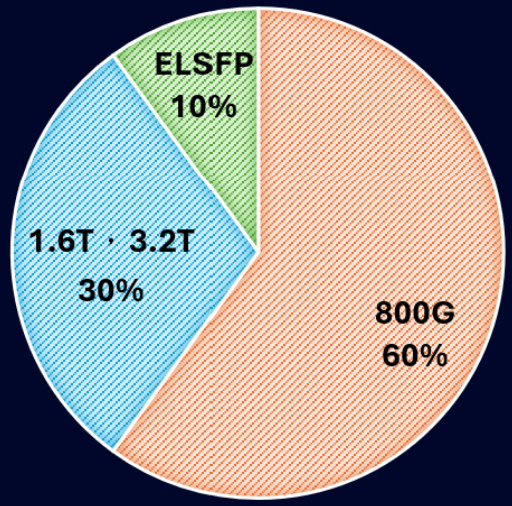
技術平台

- Flip-chip｜80%：主要量產與營收貢獻來源
- mSAP｜10%：Q3 完成認證後進入量產貢獻
- 液冷測漏板｜10%：穩定量產



產品平台

- 800G｜60%：目前市場主流需求
- 1.6T，3.2T｜30%：下一世代高速光通訊成長主軸
- ELSFP｜10%：小量量產，提前布局未來 CPO 應用



Integrated Module Solution

IMS 達成實績&核心能力升級計畫

核心能力升級路徑 Tier 1.5 → 系統整合 → Edge AI 產品 → 目標市場 **年度目標：30~50% 複合成長**

2026
- 美系新客戶營收佔比5%

現況

內飾模組 Tier 1.5

- 車載內飾模組 ODM
- 儲能Busbar
- Robotaxi 車門開關模組 已量產

2028
- 美系新客戶營收佔比8%

能力升級

SI 系統整合能力供應商

- 由模組製造走向系統整合
- 承接系統級規格與驗證

2030
- 美系新客戶營收佔比12%

產品延伸

Edge AI 產品應用

- 電源管理 · AI 視覺
- 機電測試整合/ 終端產品

市場拓展

目標市場

以核心能力切入三大市場

儲能

機器人

商用低空經濟

IMS 由車載模組延伸至 Edge AI 全關聯產業

■ *車載量產實績 · 儲能落地 · 延伸機器人 / 無人機*

車載模組 (佔比30%)

傳統內飾 → 智能外飾





已量產 **Robotaxi 車門開關模組**

北美電動車客戶 · 首款模組級 ODM 量產

研發中 全視覺**ADAS**
PMMA B 柱飾板

一體成型 · AI 視覺關聯· 車載研發項目

儲能 (佔比45%)

光電訊號傳輸 → 電源控制管理







已量產 **Busbar • 光纖聯結器**

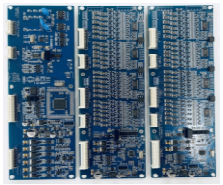
研發中 **電池管理控制**

代工起步，建立電源控制核心能力

機器人 / 無人機 (佔比25%)

電源控制 SI技術延伸應用





已落地 **AI 噴塗機器人設備**

商用整機系統已交付

研發中 **電源分配管理**

與美國商用無人機客戶洽談PDS模組量產代工

共用核心能力 (電源分配管理 · AI 視覺) · 機構+電子PCBA

Thermal Module Solution

2026 營運法說報告 TMS

截至今年九月 (2026/Q3) 表現

> 1.5 倍 超過去年全年

前九月營收已大幅超越 2025 全年

2026 全年營收預估

> 200% 年度倍增

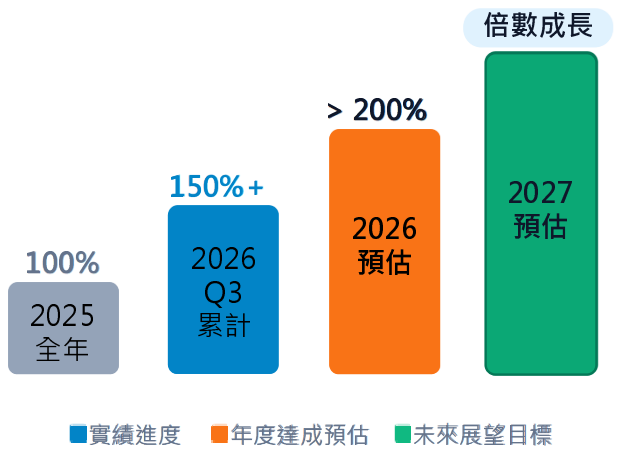
預估今年總營收將實現超過 2 倍強勁成長

利基市場產品毛利率

25% ~ 30%

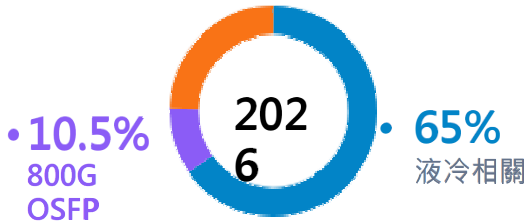
預估 2026 單位虧轉盈

營收成長趨勢示意圖 (以2025為基準 100%)



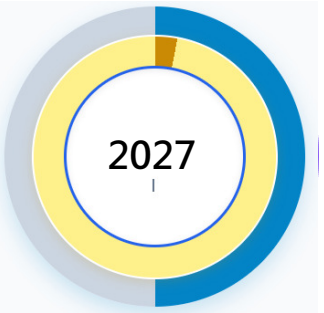
營收結構占比

目標轉變



液冷產品	65%
800G 光模組 (氣冷)	10.5%
其他氣冷產品	24.5%

營運目標願景



佔集團營收 3 %

光模組散熱 50%

光通訊散熱營收佔比	50% (倍數躍升)
其他高階散熱組件佔比	50%

終端品牌客戶認證進展與量產時程規劃

雙位倍數 成長

風冷產品 既有市場

工控市場穩定出貨

基礎產品持續穩健供應全球工控領域客戶，提供經營團隊穩固的營收基本盤與現金流。

現有主力持續深化

高階氣冷模組 2027 Q1

美系品牌廠後期認證中

某美系品牌大廠進行產品**後期驗證中**，預計 **2027 年 Q1 導入小批量產**。

驗證最後階段

光通訊散熱模組 2026 Q4

送交美系大廠測試

整合高階光模組散熱組件 **2026 Q4 送交美系品牌大廠**進行實機測試與效能驗證，預計2027 Q1 轉量產。

邁向光通訊生態系

時間軸推進： 高階氣冷 2026/Q3 送樣美系品牌大廠 → 2027/Q1 小批量產 → 2027/Q1+光通訊模組散熱機構件量產出貨。

強強聯手：垂直整合-杰華精密

攜手**杰華精密**發揮技術與產能互補優勢，共同開發高難度壓鑄機構件與散熱模組進行分階段擴廠以降低地緣風險

營運展望

營運目標及展望

01 /模組化與高附加價值產品BUSINESS TRANSFORMATION

2028年模組解決方案營收占比目標＞60%，以AI光通訊、車用電子及先進製造驅動產品組合升級。

02 /全球製造與客戶交付能力GLOBAL MANUFACTURING

深化馬來西亞產能布局，評估北美製造據點；2028年海外生產營收占比目標＞50%。

03 / AI與新技術商業化NEW GROWTH DRIVERS

AI相關應用及新技術新產品營收占比朝50%以上邁進，推動高密度互連、精密組裝與熱管理整合。

04 /營收與獲利同步成長PROFITABLE GROWTH

強化產能利用率、產品毛利結構及資本效率，推動營業利益與自由現金流持續改善。

歡迎聯繫

Eric Tseng 曾恭勝 *Spokesperson*

Tel : +886-3-3973345 ext. 18003

E-mail : ichia.ir@ichia.com

Allen Huang 黃彥翔 *Investor Relations*

Tel : +886-3-3973345 ext. 11133

Mobil: +886-987-816-292

E-mail : Allen.Huang@ichia.com

- *Company Website*
- *Financial details*

Thank You

Integrity Commitment Humanity Innovation Achievement